

マイクロシステム材料学

Material Science for Microsystems

異方性と等方性エッチング	Anisotropic etching and isotropic etching
原子間力顕微鏡	Atomic force microscope
バイモルフ	Bimorph
バーガースベクトル	Burgers vector
最密充填格子	Close-packed lattice
化学機械研磨	CMP (Chemical mechanical polishing)
接触角	Contact angle
回折	Diffraction
転位	Dislocation
ドライエッチング	Dry etching
電気二重層	Electric double layer
封止	Encapsulation
共晶	Eutectic
フェルミ準位	Fermi level
誘電性と圧電性	Ferroelectricity and piezoelectricity
フリップチップボンディング	Flip chip bonding
自由エネルギー	Free energy
結晶粒界	Grain boundary
親水性表面と疎水性表面	Hydrophilic surface and hydrophobic surface
インクジェット	Ink jet
格子欠陥	Lattice defect
格子振動	Lattice vibration
鉛フリーはんだ	Lead-free solder
リソグラフィ	Lithography
MEMS	MEMS
ミラー指数	Miller index
ナノインプリント	Nano imprint
光スイッチ	Optical switch
実装	Packaging
相平衡	Phase equilibrium
ピエゾ抵抗効果	Piezoresistive effect
めっき	Plating
p-n接合	p-n junction
Q値	Q value
反応性イオンエッチング	Reactive ion etching
逆格子	Reciprocal lattice
リフローはんだづけ	Reflow soldering
レジスト	Resist
犠牲層	Sacrificial layer
ショットキーバリア	Schottky barrier
自己組織化	Self assembly
センサネットワーク	Sensor network
単結晶	Single crystal
スパッタリング	Sputtering
応力と歪	Stress and strain
表面マイクロマシニング	Surface micromachining
引張強度	Tensile strength
ワイヤボンディング	Wire bonding
配線基板	Wiring board